

各 位

会 社 名 新光電気工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 倉 嶋 進
コード番号 6967 東証第1部
問 合 せ 先 経営企画室長 清 野 貴 博
Tel (026) 283-1000 (代)

成長市場向け設備投資の実施について

AI、IoTのさらなる活用や5Gの実用化等を背景とする社会・経済のデジタル化の進展とともに、今後、半導体は幅広い分野において用途を広げ、市場はさらに拡大することが想定されます。当社は、高い成長が見込まれる市場分野向けに重点的に経営資源を投下してまいりましたが、今般、半導体市場における今後の需要拡大に対応するため、当社主力製品である高性能半導体向けフリップチップタイプパッケージの生産体制強化を目的として、生産拠点の新設等、下記のとおり設備投資を実施することを決定いたしました。

また、半導体製造装置市場の拡大により需要増加が見込まれるセラミック静電チャックの生産能力増強をはかるため、当社高丘工場（長野県中野市）内に新棟建設を計画しておりますので、あわせてお知らせいたします。

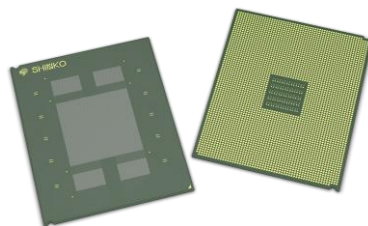
記

1. フリップチップタイプパッケージの生産体制強化

- (1) 計 画 概 要 : パソコンやサーバーなどに搭載されるCPU等の高性能半導体向けフリップチップタイプパッケージは、半導体の高機能化・高速化と省電力化に対応する半導体パッケージとして、今後も旺盛な需要が続くことが見込まれます。当社におきましては、これまで更北工場（長野市）、若穂工場（同）および高丘工場（長野県中野市）において、フリップチップタイプパッケージの生産体制強化に努めてまいりましたが、さらなる生産能力拡充をはかるべく、新たな拠点を開設し4工場体制とするとともに、更北工場・若穂工場における生産能力増強をはかるものです。
- (2) 投 資 額 : 2022～2025年度投資額計 1,400億円
- (3) 生 産 能 力 : 本設備投資によりフリップチップタイプパッケージの生産能力は、現行比約50%程度増強することを見込んでおります。
- (4) 新拠点の概要（予定）
- | | |
|---------|-----------------------------------|
| ①所在地 | 長野県千曲市 |
| ②スケジュール | 2022～2023年度 建設工事
2024年度以降 順次稼働 |

※新拠点につきましては、現在関係各機関との協議を含め詳細検討中のため、確定次第別途お知らせいたします。

更北工場・若穂工場における設備投資につきましては、2023年度より稼働開始することを予定しております。



フリップチップタイプパッケージ

[フリップチップタイプパッケージについて]

フリップチップタイプパッケージは、パソコンやサーバーのCPUをはじめとする高性能半導体に使用されている半導体パッケージです。半導体のさらなる高機能化・高速化と省電力対応のため、半導体パッケージの重要性が増しており、当社のフリップチップタイプパッケージは、最先端のパッケージングテクノロジーにより、微細な配線パターンや多層構造、優れた電気特性を実現し、お客様のニーズにお応えしています。

2. セラミック静電チャックの生産能力増強

- (1) 計画概要： 中長期的な半導体市場の拡大を背景に、半導体製造装置の基幹部品であるセラミック静電チャックは、今後さらに需要が大きく伸長することが見込まれることから、高丘工場内（長野県中野市）に新棟を建設し生産能力増強をはかるものです。
- (2) 投資額： 2021～2023年度投資額計 180億円
- (3) 生産能力： 本設備投資によりセラミック静電チャックの生産能力は、既存棟において既に着手している設備投資による寄与分を含め、現行比約2倍程度に増強することを見込んでおります。
- (4) 新棟の概要（予定）
- | | |
|----------|--|
| ① 所在地 | 高丘工場内（長野県中野市） |
| ② 建物構造 | 鉄骨造 5階建 |
| ③ 延床面積 | 28千㎡ |
| ④ スケジュール | 2021年12月 着工
2023年3月 竣工
2023年度下期 稼働開始 |



セラミック静電チャック

[セラミック静電チャックについて]

セラミック静電チャックは、半導体製造工程において静電気をを用いて半導体の原材料であるシリコンウエハーを吸着・固定する部品です。当社のセラミック静電チャックは、エッチング装置等の半導体製造装置用として幅広く使用されております。当社は、セラミックの焼成から加工、組立および検査の一貫生産による強みを活かし、高品質、低価格、短納期を実現し、お客様の最先端のニーズにあわせた静電チャックを提供しています。

当社は、引き続き成長が見込まれる半導体産業にあつて、高性能半導体向けフリップチップタイプパッケージ、半導体製造装置向けセラミック静電チャックをはじめとして、成長市場向けの設備投資を今後とも重点的に展開し、お客様にとって価値の高い製品・サービスを提供することを通じ、豊かな社会づくりに貢献し、一層の成長・発展をはかることを目指してまいります。

なお、当社におきましては、2018年度より高丘工場等においてフリップチップタイプパッケージの生産体制強化のための大型設備投資を実施してまいりましたが、フリップチップタイプパッケージの旺盛な需要のもと、今後、当該設備投資による生産能力増強の収益寄与が本格化する見込みです。このたびのフリップチップタイプパッケージの新拠点開設等の設備投資に必要な資金につきましては、これらの収益をはじめとする自己資金ならびに借入等をもって充当する方針です。

※ 上記のフリップチップタイプパッケージ、セラミック静電チャックへの設備投資は、2023年度より順次稼働を開始することを予定しているため、このたびの設備投資計画による2022年3月期連結業績に与える影響につきましては軽微であります。

なお、今後開示が必要な事項が発生した場合は、適時開示を行う予定です。

以 上